

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成29年7月6日(2017.7.6)

【公開番号】特開2015-38188(P2015-38188A)

【公開日】平成27年2月26日(2015.2.26)

【年通号数】公開・登録公報2015-013

【出願番号】特願2014-118092(P2014-118092)

【国際特許分類】

C 08 F 230/08 (2006.01)

C 09 D 4/00 (2006.01)

C 08 F 220/20 (2006.01)

B 05 D 7/24 (2006.01)

【F I】

C 08 F 230/08

C 09 D 4/00

C 08 F 220/20

B 05 D 7/24 302Y

【手続補正書】

【提出日】平成29年5月23日(2017.5.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

酸性基と第1の重合性基とを有する第1の化合物と、
ケイ素原子と、前記ケイ素原子に結合した酸素原子と、前記酸素原子に結合した水素原子と、第2の重合性基と、を有する第2の化合物と、
を含む組成物。

【請求項2】

請求項1に記載の組成物において、

前記第1の化合物の含有量が0.01重量%～10重量%であり、且つ前記第2の化合物の含有量が0.1重量%～50重量%であること、
を特徴とする組成物。

【請求項3】

請求項1又は2に記載の組成物において、さらに
第3の重合性基を有する第3の化合物を含むこと、
を特徴とする組成物。

【請求項4】

請求項3に記載の組成物において、
前記第3の化合物は、さらに第4の重合性基を有していること、
を特徴とする組成物。

【請求項5】

請求項1又は2に記載の組成物において、さらに
照射により結合が開裂する結合を含む第4の化合物を含むこと、
を特徴とする組成物。

【請求項6】

請求項 1 又は 2 に記載の組成物において、
前記第 2 の化合物は、シランカップリング剤であること、
を特徴とする組成物。

【請求項 7】

請求項 1 又は 2 に記載の組成物において、
前記第 1 の化合物は、さらに第 5 の重合性基を有すること、
を特徴とする組成物。

【請求項 8】

部材を製造する方法であって、
基材を用意する工程と、
前記基材上に請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の組成物を配置する工程と、
前記組成物を硬化させる工程と、
を含むこと、
を特徴とする部材の製造方法。

【請求項 9】

請求項 8 に記載の部材の製造方法において、
前記基材は、無機部分を含み、
前記組成物を配置する工程は、前記組成物が前記無機部分と接触するように行われるこ
と、
を特徴とする部材の製造方法。

【請求項 10】

請求項 9 に記載の部材の製造方法において、
前記無機部分は、酸化ケイ素又はケイ素からなること、
を特徴とする部材の製造方法。

【請求項 11】

請求項 8 に記載の部材の製造方法において、
前記組成物を硬化する工程は、前記基材とモールドとの間に組成物が挟まれた状態で行
われ、
前記モールドは、複数の第 1 の部分と複数の第 2 の部分とが形成された第 1 の表面と、
第 2 の表面と、を含み、
前記複数の第 1 の部分と前記第 2 の表面との距離である第 1 の距離は、前記複数の第 2
の部分と前記第 2 の表面との距離である第 2 の距離より大であること、
を特徴とする部材の製造方法。

【請求項 12】

無機部分と、
有機部分と、
を含む部材であって、

前記有機部分は請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の組成物を用いて形成された、各々
が炭素原子に結合した複数のケイ素原子と酸性基を有するポリマーと、を含む部材。

【請求項 13】

請求項 12 に記載の部材において、
前記無機部分は酸素原子を含み、
前記複数のケイ素原子の各々は、前記無機部分に含まれる酸素原子に結合していること
、を特徴とする部材。

【請求項 14】

請求項 12 に記載の部材において、
前記複数のケイ素原子の各々は、前記無機部分に含まれる酸素原子と共有結合している
こと、
を特徴とする部材。

【請求項 15】

部材を有するデバイスを製造する方法であって、
基材を用意する工程と、
前記基材上に請求項 1 ~ 7 のいずれか一項に記載の組成物を配置する工程と、
前記組成物を硬化させて前記部材を得る工程と、
を含むデバイスの製造方法。

【請求項 1 6】

請求項 1 5 に記載のデバイスの製造方法において、さらに
金属部分が形成されている第 1 の機能層を形成する工程を含むこと、
を特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項 1 7】

請求項 1 6 に記載のデバイスの製造方法において、さらに、
半導体膜が形成された第 2 の機能層を形成する工程を含むこと、
を特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項 1 8】

請求項 1 5 に記載のデバイスの製造方法において、
前記デバイスは、電気光学素子であること、
を特徴とするデバイスの製造方法。

【請求項 1 9】

請求項 1 5 に記載のデバイスの製造方法において、さらに
金属配線が形成された第 1 の機能層を形成する工程と、
半導体膜が形成された第 2 の機能層を形成する工程と、を含み、
前記金属配線は、前記デバイスの中で電気的に前記半導体膜に接続されていること、
を特徴とするデバイスの製造方法。